

杭州士兰微电子股份有限公司

关于与大基金二期共同向士兰集科增资完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第三十二次会议和 2022 年 3 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》：本公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）以货币方式共同出资 885,000,000 元认缴厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）新增的全部注册资本 827,463,681 元，其中：本公司出资 285,000,000 元认缴新增注册资本 266,471,355 元；大基金二期出资 600,000,000 元认缴新增注册资本 560,992,326 元。本次增资溢价部分计入士兰集科的资本公积。士兰集科另一方股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）放弃优先认购权。本次增资完成后，士兰集科的注册资本将由 3,000,490,000 元增加为 3,827,953,681 元。同时，本公司拟与大基金二期、厦门半导体及士兰集科签署与本次增资相关的《增资协议》。

本次增资完成前后，士兰集科的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	255,041.65	85	255,041.65	66.626
2	杭州士兰微电子股份有限公司	45,007.35	15	71,654.4855	18.719
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	-	56,099.2326	14.655
合计		300,049.00	100	382,795.3681	100

（上述士兰集科增资前认缴注册资本 300,049 万元已全部实缴到位。）

上述事项详见公司于 2022 年 2 月 22 日和 3 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告（公告编号：临 2022-009、临 2022-013）。

二、投资进展情况

1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的批准及授权，董事长陈向东先生代表公司与大基金二期、厦门半导体及士兰集科签署了《增资协议》。士兰集科已于 2022 年 4 月 6 日办理完成了相应的工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的新营业执照（详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露的《对外投资进展公告》，公告编号：临 2022-026）。

2、公司与大基金二期根据《增资协议》以货币方式共同认缴的出资 885,000,000 元已于近日全部实缴到位。士兰集科最新的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
厦门半导体投资集团有限公司	255,041.65	255,041.65	66.626
杭州士兰微电子股份有限公司	71,654.4855	71,654.4855	18.719
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	56,099.2326	56,099.2326	14.655
合计	382,795.3681	382,795.3681	100.00

三、投资事项对上市公司的影响

本次增资事项的顺利完成进一步增加了士兰集科的资本充足率，有利于加快推动士兰集科 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营，为本公司提供产能保障，对本公司的经营发展具有长期促进作用。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日